

次世代低反りBTレジン積層板材料「HL832RS/GHPL-830RS」が「第20回JPCA賞（アワード）」を受賞

2024年6月10日

三菱ガス化学株式会社(本社：東京都千代田区、社長：藤井 政志、以下、当社)は、次世代低反りBTレジン積層板材料「HL832RS/GHPL-830RS」にて「第20回JPCA賞（アワード）」を受賞いたしました。

「JPCA賞(アワード)」は、一般社団法人 日本電子回路工業会(JPCA)が主催、運営する電子機器トータルソリューション展2024（JPCA Show、マイクロエレクトロニクスショー、JISSO PROTEC、メタバースデバイス展、WIRE Japan Show、Electronics Component & Unit Show、E-Textile/Wearable、Smart Sensing、無人化ソリューション展、Edge Computing）における新製品、新技術の促進による活力の向上と総合的な技術の進歩発展を目的として実施され、全出展企業の中から審査にエントリーした製品・技術より選出されます。

審査は学術界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々に構成するJPCA賞（アワード）選考委員会にて実施され、「独創性（独自性・オリジナリティ）」、「産業界での発展性・将来性」、「信頼性」、「時世の適合性」を基準に選考されます。

【受賞製品・技術について】

当社は独自のBT樹脂技術による高耐熱性積層材料を提供しており、半導体パッケージ用途などで広くご利用いただいています。この度、当技術をさらに進化させ、低反り性、優れたメカニカル加工性、優れた平坦性を有し、幅広いパッケージ形態に適用可能なHL832RS/GHPL - 830RSを開発しました。

半導体の高性能化に伴い、性能とコストの両立を目指す観点から、チップレット*を採用したパッケージの実用化が進んでいます。チップレットでは、複数の半導体チップがインターポーザーを介して接続されますが、これによりパッケージが大型化し、パッケージの反りが増大する課題があります。この課題に対し、低反り性に加え、優

れたメカニカル加工性、優れた平坦性を兼ね備えた積層材料を当社のユニークな樹脂改良技術で達成したことが高く評価され、本賞の受賞に至りました。

当社は引き続き新しい技術を追求し、BT積層材料の可能性をお客様のご要求に迅速に応え、高度な情報通信社会の発展に貢献してまいります。

*チップレット・・・CPUやGPUなどの要素を個々に設計・製造し、パッケージ上にインテグレーションすることで1つの半導体にする設計・製造概念

以 上

お問い合わせ先

三菱ガス化学株式会社
総務人事部広報グループ
TEL:03-3283-5040

お問い合わせ先

[ニュースリリース一覧にもどる](#)